

2019年度[2020年3月期] 第2四半期 決算説明会

2019年11月11日
住友ベークライト株式会社
代表取締役社長
藤原 一彦

2019年度決算 [2020年3月期] 第2四半期 決算の概要

2019年度 第2四半期業績[IFRS]

[金額単位：億円]

	2018年度 ['19年3月期] 第2四半期①	2019年度 ['20年3月期] 第2四半期②	前年同期比較	
			金額 (②-①)	増減率
売上収益	1,083	1,050	-34	-3.1%
事業利益	95	85	-10	-10.9%
営業利益	91	83	-8	-9.0%
当期利益	70	73	3	4.3%

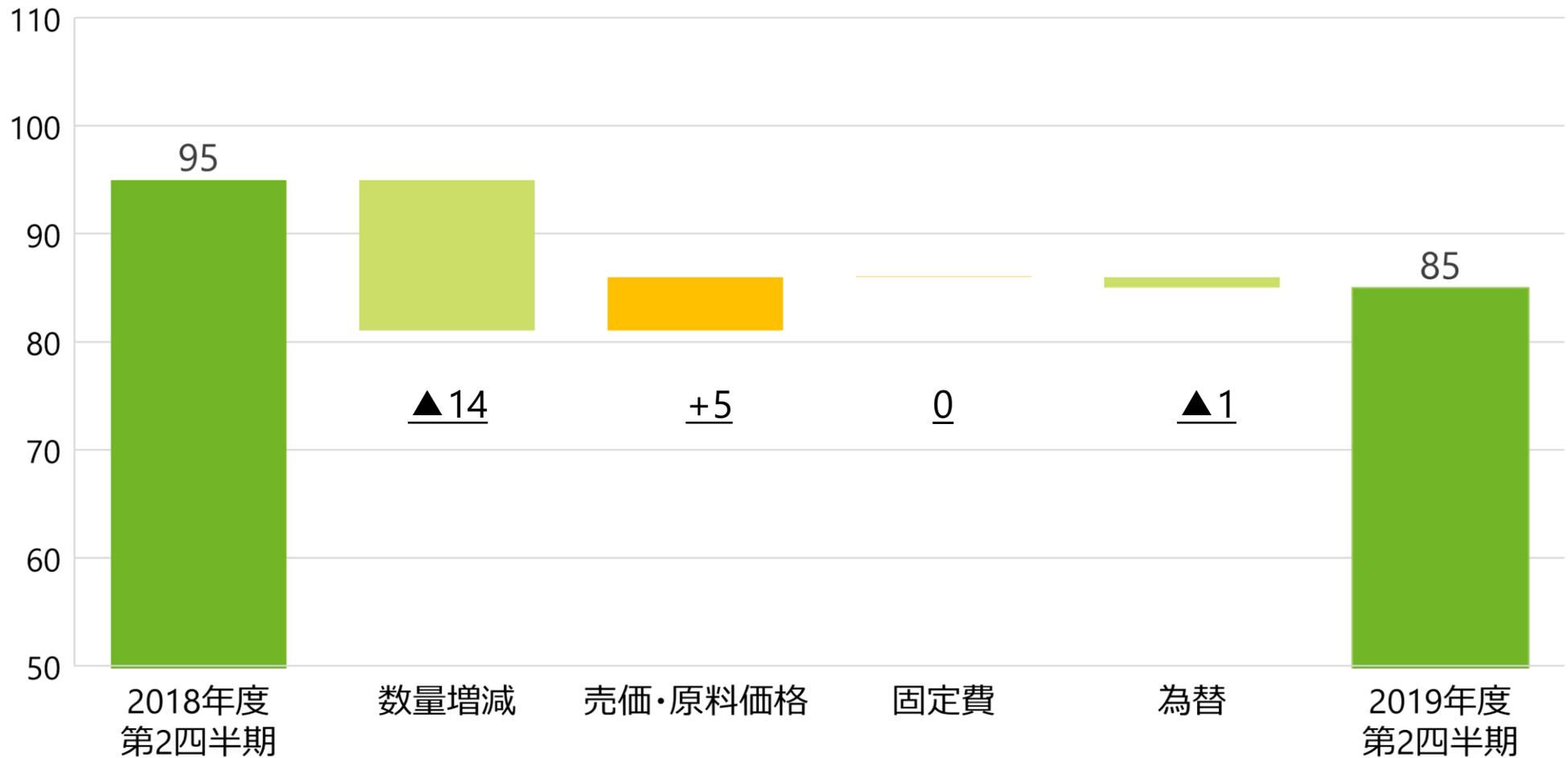
為替レート

USD (\$/¥)	110.07	109.00	-	-
EUR (€/¥)	129.88	121.43	-	-

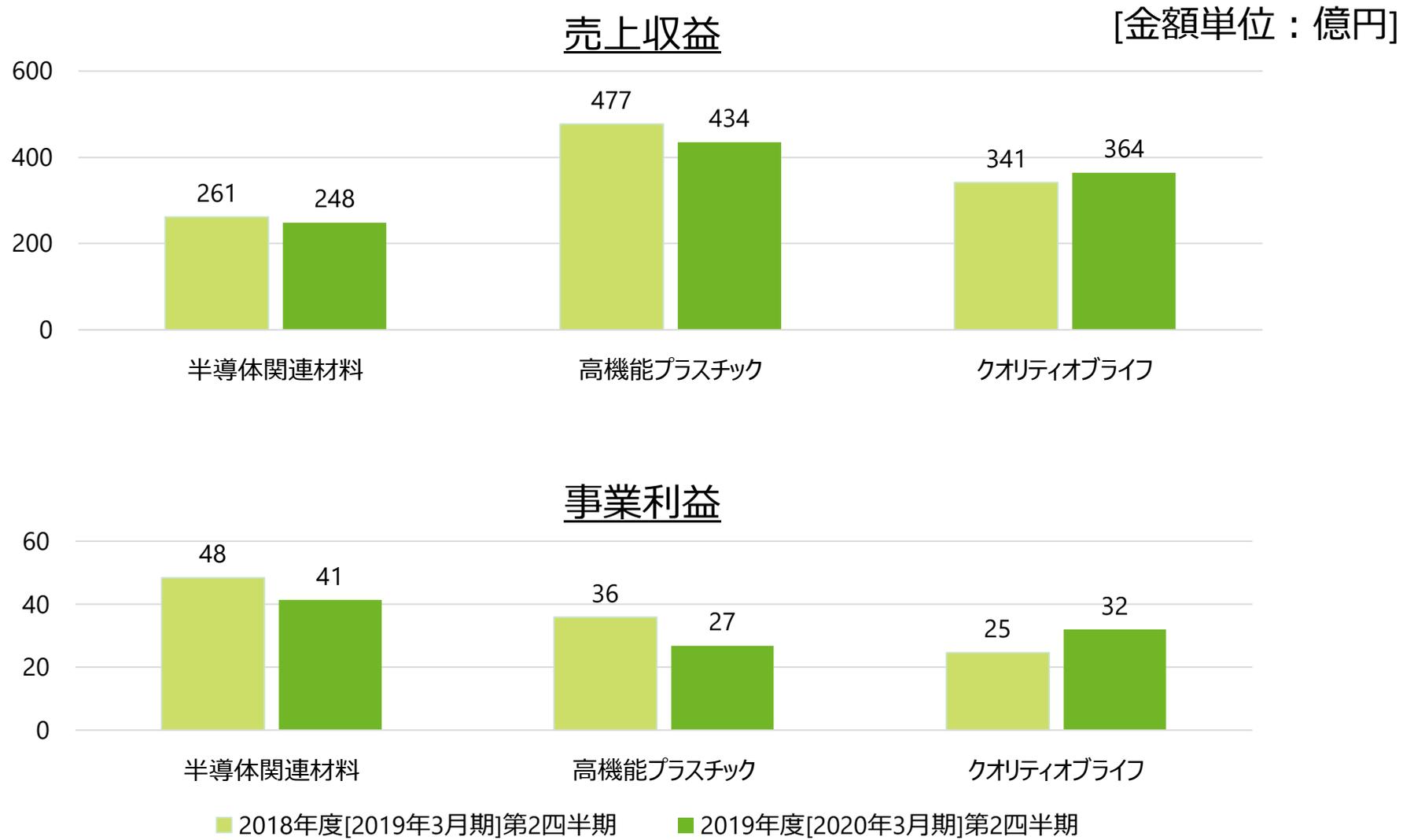
※「事業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販管費及び一般管理費」を控除したベース
「当期利益」は親会社所有者に帰属する四半期利益

事業利益増減要因・前年同期比[IFRS]

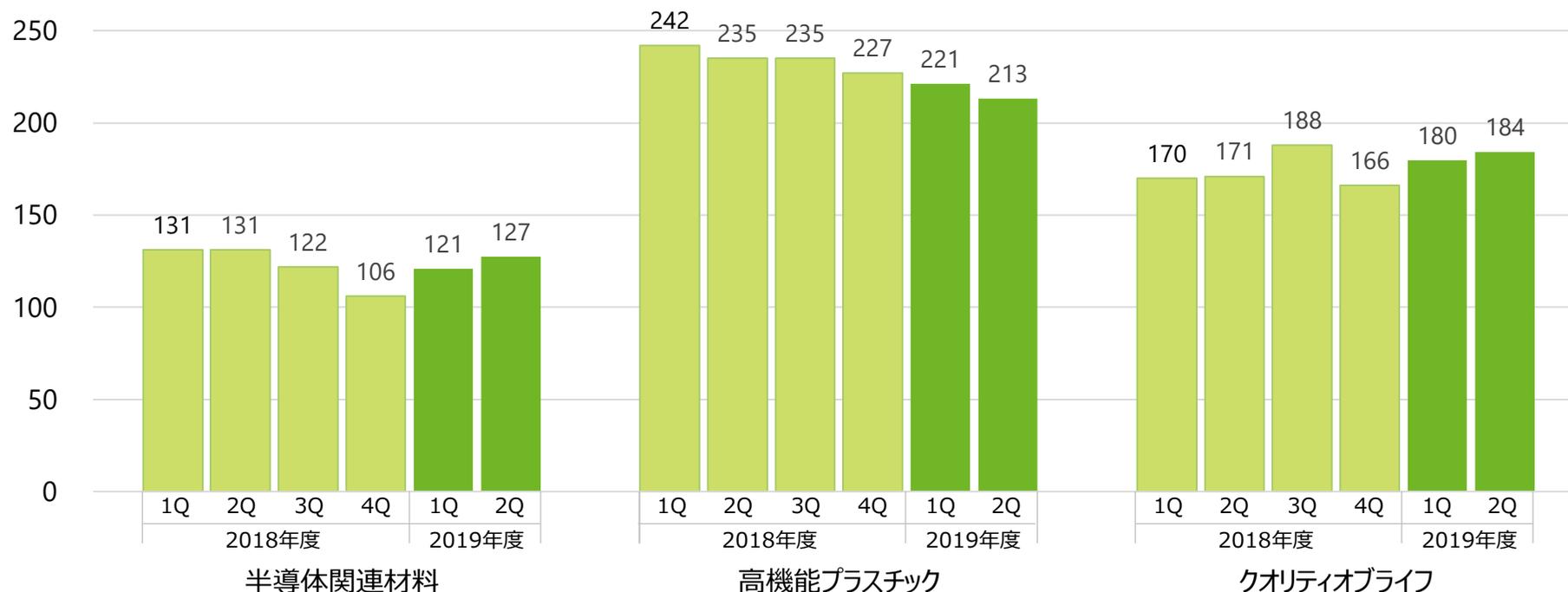
[金額単位：億円]



事業セグメント別業績比較[IFRS]



事業セグメント別四半期販売推移



- 半導体材料は主力の封止材が前3Q以降急落し、当1Qより数量が増加したものの本格回復までには至らず。
- 高機能プラスチックも中国、欧州の自動車市況の悪化に加え、北米も減速感が現れ減少基調。
- クオリティオブライフは医薬品包装用フィルムなどが牽引し1Q以降前年を上回る水準で増加傾向で推移。

2019年度 [2020年3月期] 業績予想

当社を取り巻く事業環境

社会情勢

- ・米中貿易摩擦による景気影響、英国のEU離脱等政情不安で依然先行き不透明

原料価格動向

- ・原油価格は景気減速に伴う需要減で軟調。減産等で価格を下支えするも需要が強まる兆しがなく、石化原料も現行水準で推移

エレクトロニクス

- ・スマホ関連で次世代通信規格「5G」の商用化などで持ち直しの兆しが現れるも、PCやサーバー等の需要は力強さに欠け、依然本格的回復には至らず。2020年以降のIoTや5Gによる需要喚起に期待

自動車

- ・欧州は2018年9月の新燃費試験(WLTP)導入以降、未だ回復が見られず中国も低調で、さらに底堅かった北米も需要が減速

住宅(国内)

- ・新設住宅着工戸数は、貸家は依然低調で、持ち家なども住宅ローン減税の延長など実施するも伸び悩む

2019年度 業績予想[IFRS]

[金額単位：億円]

	2018年度 ['19年3月期] 実績①	2019年度 ['20年3月期] 予想②	前年同期比較		2019年度 ['20年3月期] 当初予想③
			金額 (②-①)	増減率	
売上収益	2,130	2,050	-80	-3.7%	2,200
事業利益	173	160	-13	-7.5%	200
当期利益	151	123	-28	-18.5%	151

為替レート

USD (\$/¥)	110.69	108.00	-	-	110.00
EUR (€/¥)	128.43	120.00	-	-	125.00

※「事業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販管費及び一般管理費」を控除したベース
「当期利益」は親会社所有者に帰属する当期利益

基本方針および基本戦略

基本方針

SDGsに則した“**One Sumibe**”活動の実践により、機能性化学分野での「**ニッチ&トップシェア**」の実現とともに、事業規模の拡大を図る。

SDGsを重点領域を核に推進



■ SDGs貢献製品売上比率

2018年度 23% ▶ 2021年度 30%

SDGs貢献領域(5+1)



One Sumibe活動をWWに展開

- お客様に全社横断的価値の提供
- お客様の潜在ニーズと事業機会の創出

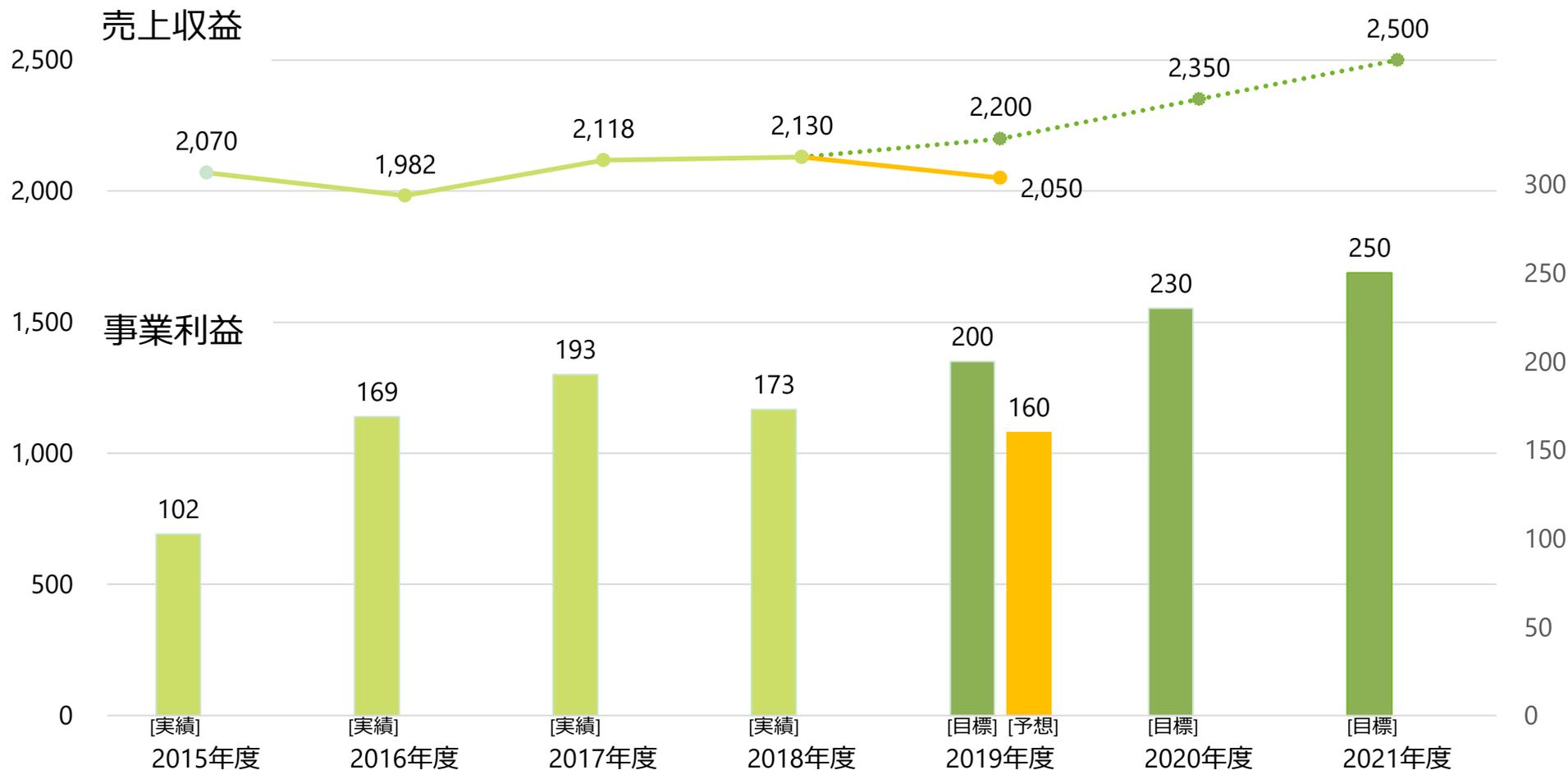


基本戦略

- 競争優位性のある新製品の開発、早期戦力化
- 既存製品の収益力強化、領域(用途・地域)拡大
- 成長領域における積極的な戦略投資(M&A等)

業績の推移

[金額単位：億円]



2019年度は想定以上の市況低迷により、中期経営目標比で少なくとも1年遅れの見通し

事業セグメント別 下期重点施策

半導体関連材料

■ “生・販・研” 一体対応によるシェア拡大： 目標・WWシェア40%超

- ▼ 新規開拓および既存顧客のインナーシェアUP(特に中国)
- ▼ CCSB(中国)との連携強化

■ 伸びる車載用途で市場創造、量拡大： 目標・車載比率30%超

- ▼ ゼロディフェクトによる競争優位性の強化
- ▼ オープンラボ(欧米亜日)の対応力強化、社外との協業推進

■ 高集積デバイス領域での事業拡大

- ▼ MUF/圧縮成形用顆粒封止材の適用拡大
- ▼ 先端PKG用材料の開発、実績化促進
(パワー半導体用材料、5G関連材料等)

高機能プラスチック

■ グローバル3戦略製品をはじめ車載用途でのシェア拡大



■ 成長分野での事業強化による事業ポートフォリオの最適化

▼ 航空機分野

- ・Boeing以外の顧客層拡大、アフターマーケットの開拓
... 欧州拠点(独) 開設、中国(東莞)拠点の直販化
- ・北米拠点の収益基盤強化

▼ エネルギー分野

- ・シェールガス・オイル採掘用部材の適用部位拡大、拡販

■ 競争優位製品の開発、早期戦力化

▼ 放熱部材(12W放熱基板、放熱シート)、高寸法精度材

- ▼ 車載大容量部品用代替材料の開発、e-Axleへの展開
... Fraunhofer(独)など社内外との協業促進



■ フラックプラグ用材料(長繊維材)



■ 放熱シート



■ 高寸法精度材

クオリティオブライフ(ヘルスケア)

【医療機器】

■ 成長領域・低侵襲治療分野への展開

- ・低侵襲治療デバイスの開発促進、品揃え強化
(マイクロカテーテル、ステント等)

■ 新営業体制による専門性を武器とした拡販

ヘルスケア営業本部



サージカル製品
(外科治療)



エンドスコープ製品
(内視鏡治療)



バスキュラーIVR製品
(血管内治療)

■ 社外との連携、協業によるWWでの事業規模拡大

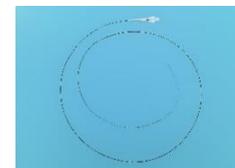
[医療機器] : オリンパス(米)、Merit Medical社との販売連携
川澄化学工業(株)との販売網、製品領域でのシナジー発揮

[バイオ] : SBバイオサイエンス(株)とのシナジー最大化
⇒事業効率化の検討、実施(尼崎、神戸事業所への集約)

＜低侵襲デバイス 代表的な製品＞



■ マイクロ能動カテーテル



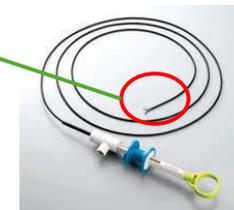
■ 脳用マイクロカテーテル



■ 消化管ステント



■ 内視鏡クリップ



■ SBナイフ®

sumius

クオリティオブライフ(フィルムシート)

【医療包装用】

■ 医薬品包装用でダントツシェアのさらなる拡大

- ▼主要顧客でのインナーシェアアップ... '19年ジェネリック向け採用率 90%超！
- ▼製品ラインナップの拡充(高防湿オレフィンシート等)



■ 医薬品包材

■ 機能性医療用包材の開発、実績化

- ▼『中国(南通)供給』×『イージーピール技術』×『日本品質管理』による差別化



■ 輸液用包材

【食品包装用】

■ 環境関連製品を核とした品揃え強化、拡販

... スキンパック、防カビフィルム、バイオマスフィルム、極薄減容フィルム等

消費期限延長、廃棄量減少



■ スキンパック



■ 防カビフィルム

【産業用】

■ 中国(南通)拠点を武器にローカル企業への拡販

... 中国半導体、電子部品メーカー等



■ カバーテープ



■ ダイシングフィルム



■ FPC用離型フィルム

クオリティオブライフ(産業機能材・建装材)

【産業機能性材料】

■ 差別化、高採算品へのシフト

- ▼ 光学制御技術を武器に事業拡大(車載、セキュリティ等)
- ▼ 既存高採算品の収益力強化(波板など)
⇒ 生産性UPと低価格原料

HUD
(Head Up Display)



■ HUD用フィルター

カメラ・センサー



■ 選択波長遮蔽ポリカ

二輪風防



【建装材】

■ 戦略製品の投入による差別化

- ▼ 不燃メラミン化粧シート・イノベア
価格競争力のある製法確立による適用範囲拡大
... 従来のエレベータ内壁から廊下等の大壁面
- ▼ 屋根用防水断熱パネル・スミルーフDNの拡販



■ イノベア・ロール品

キズや汚れなどに強い
+
曲げやすく施工性が高い



当社独自の防水性能を有する高耐久塩ビ鋼板

性能の高い断熱材

塗装ガルバリウム鋼板

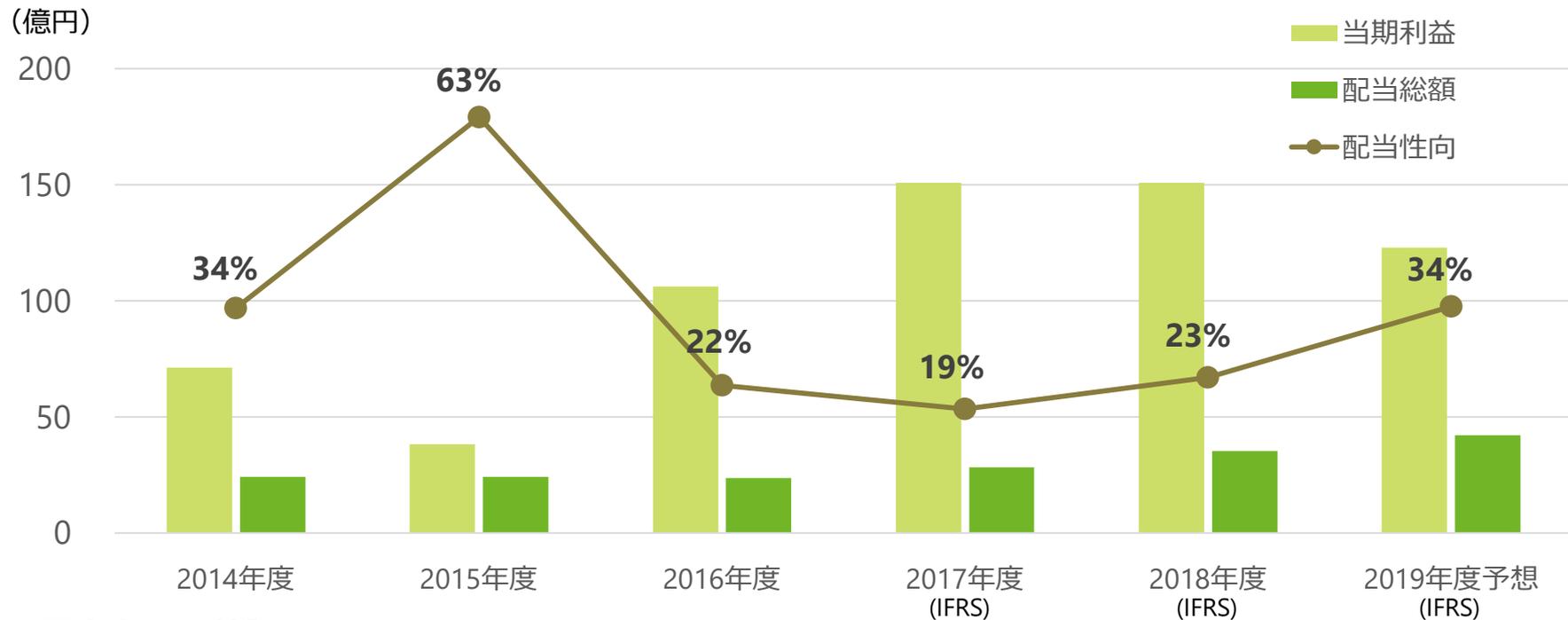
軽量、高断熱、工期短縮

■ 大面積(マンション、工場、倉庫)、住宅リフォーム向け拡販

- ▼ 施主、設計、ゼネコンとの関係強化・協業

配当予想

■ 配当金額 : 90円/1株(中間45円・期末45円)



【配当金(円)/株】

	2014	2015	2016	2017	2018	2019予想
中間配当	5.00	5.00	5.00	6.00	7.50	45.00
期末配当	5.00	5.00	5.00	6.00	7.50	45.00
年間配当	10.00	10.00	10.00	12.00	15.00	90.00

※2018年10月に株式併合(5株 ⇒ 1株)を実施したが、2018年度は併合前ベースで表記。